2026年11月13日

日本電子材料株式会社

2027年3月期第2四半期決算説明会

本プレゼンテーションに記載されている情報は、現時点で当社が入手可能なデータおよび合理的と判断した前提に基づいて構成されています。しかしながら、当社の実際の業績や将来の見通しは、経済環境の変化、半導体業界における世界的な需給バランスの変化など、数多くの不確実な要因に影響を受ける可能性があります。このため、本プレゼンテーションの記載内容とは大きく異なる場合があることを予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

本日の要点(サマリー)

1. 中間期として過去最高の売上・利益を達成、通期業績予想の再上方修正

2. 主力ラインの段階的能力増強とフル稼働による高い収益性の定着

3. AI需要に代表される構造的な拡大に向け、新工場の建設・立ち上げ準備を着実に推進

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

本日の内容

1. 2027年3月期　第2四半期連結決算概要

　　執行役員　管理部門統括部長　石本　浩久

2. 2027年3月期　通期連結業績予想の修正
　　中長期の事業環境見通しと持続的成長に向けた事業基盤の確立

　　代表取締役社長　社長執行役員　坂田　輝久

3. 質疑応答

※中間期の財務諸表等につきましては、11月10日に開示いたしました「決算補足説明資料」をご参照ください。

Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

2027年3月期　第2四半期連結決算概要

執行役員　管理部門統括部長　石本　浩久

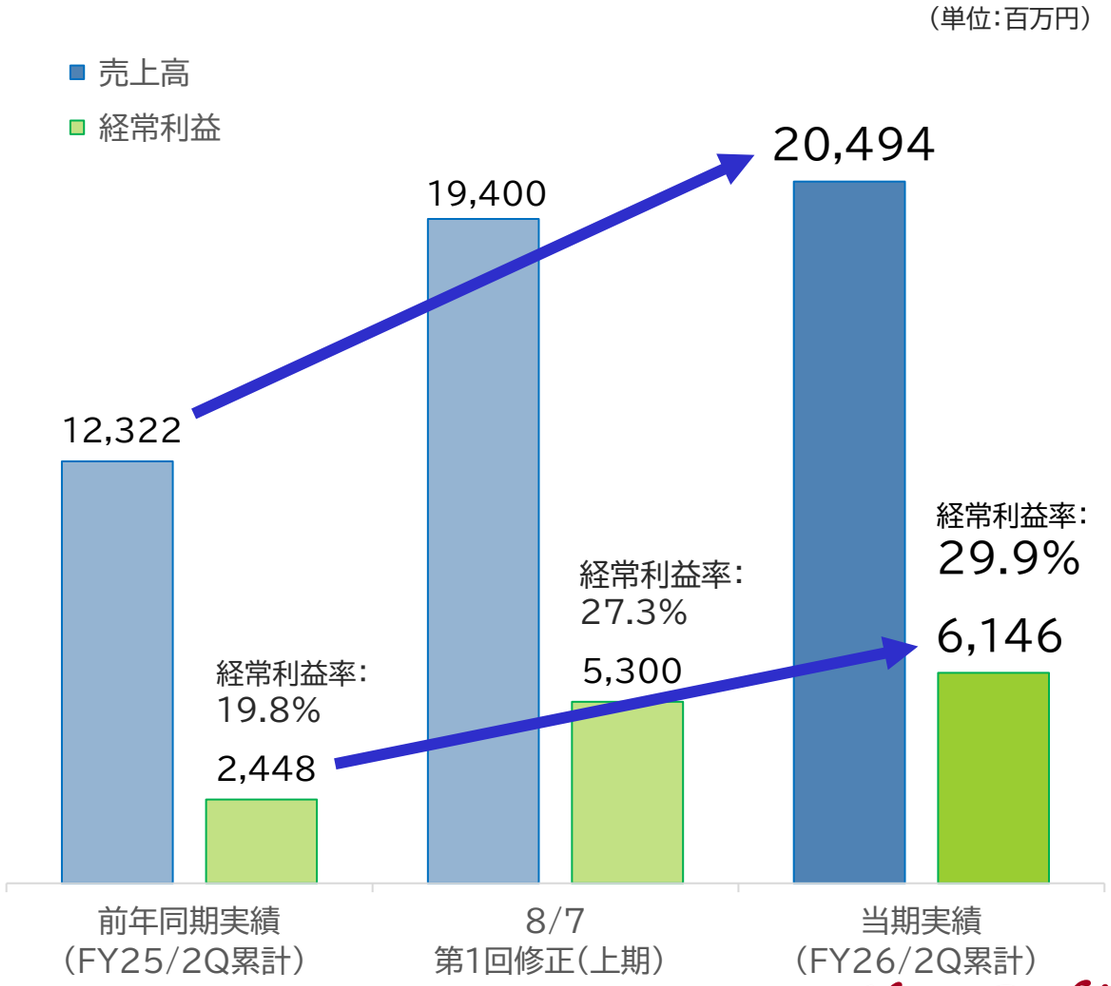
Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

2027年3月期 第2四半期連結業績概要

執行役員
管理部門統括部長
石本　浩久

・前年同期比 売上高は＋81億円（＋66.3%）、経常利益は＋36億円（+151.0%）
・第1回修正（8/7）対比でも売上・利益ともに上振れ達成



売上要因

・生成AI・サーバー需要の拡大を背景に、先端メモリ向けを中心とする主力プローブカードの受注・出荷が伸長し、中間期での過去最高売上を達成

利益要因

・重点工程の能力増強と工場の高稼働維持が奏功
・為替相場の追い風も加わり、中間期での過去最高益を達成

その他

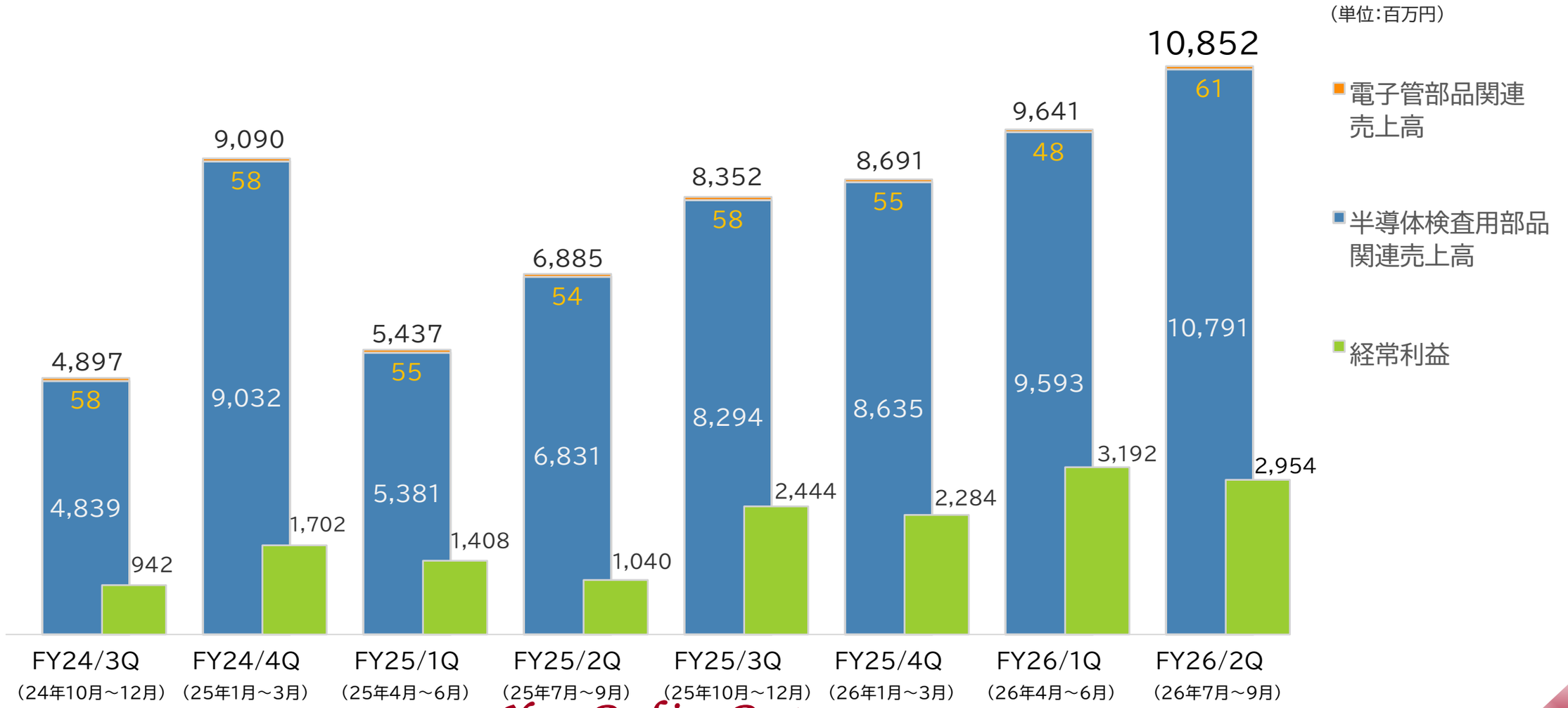
・設備・開発・人材への成長投資を引き続き推進
・熊本地震による業績への影響は軽微

Your Probing Partner

四半期業績推移

執行役員
管理部門統括部長
石本　浩久

・先端メモリの需要拡大に支えられ、FY25/1Q以降は四半期売上が右肩上がりで推移
・FY26は四半期売上の高水準な推移が定着し、成長が一段と加速



Your Probing Partner

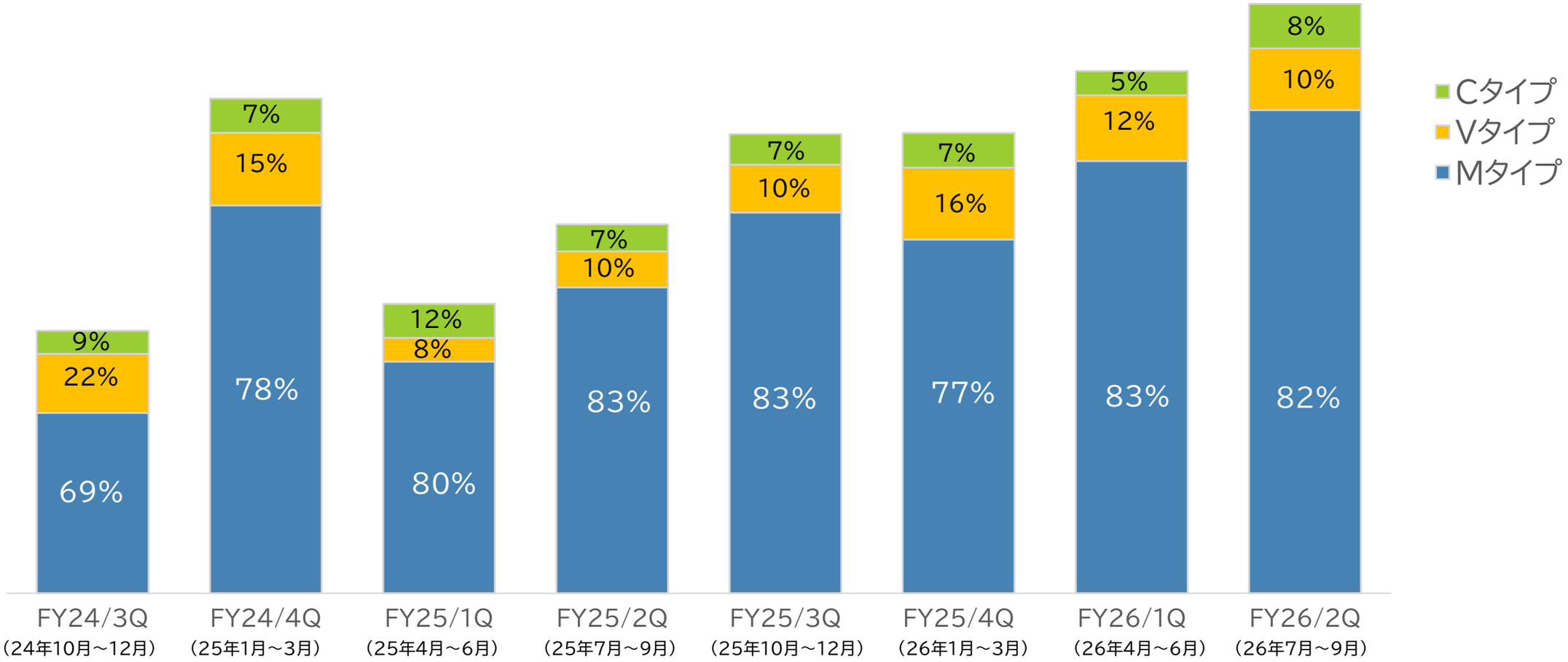
©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

四半期業績推移（プローブカードタイプ別）

執行役員
管理部門統括部長
石本　浩久

・先端分野向け主力製品（Mタイプ）の構成比が8割超で推移し、高い収益性を実現

（単位未満切捨て）



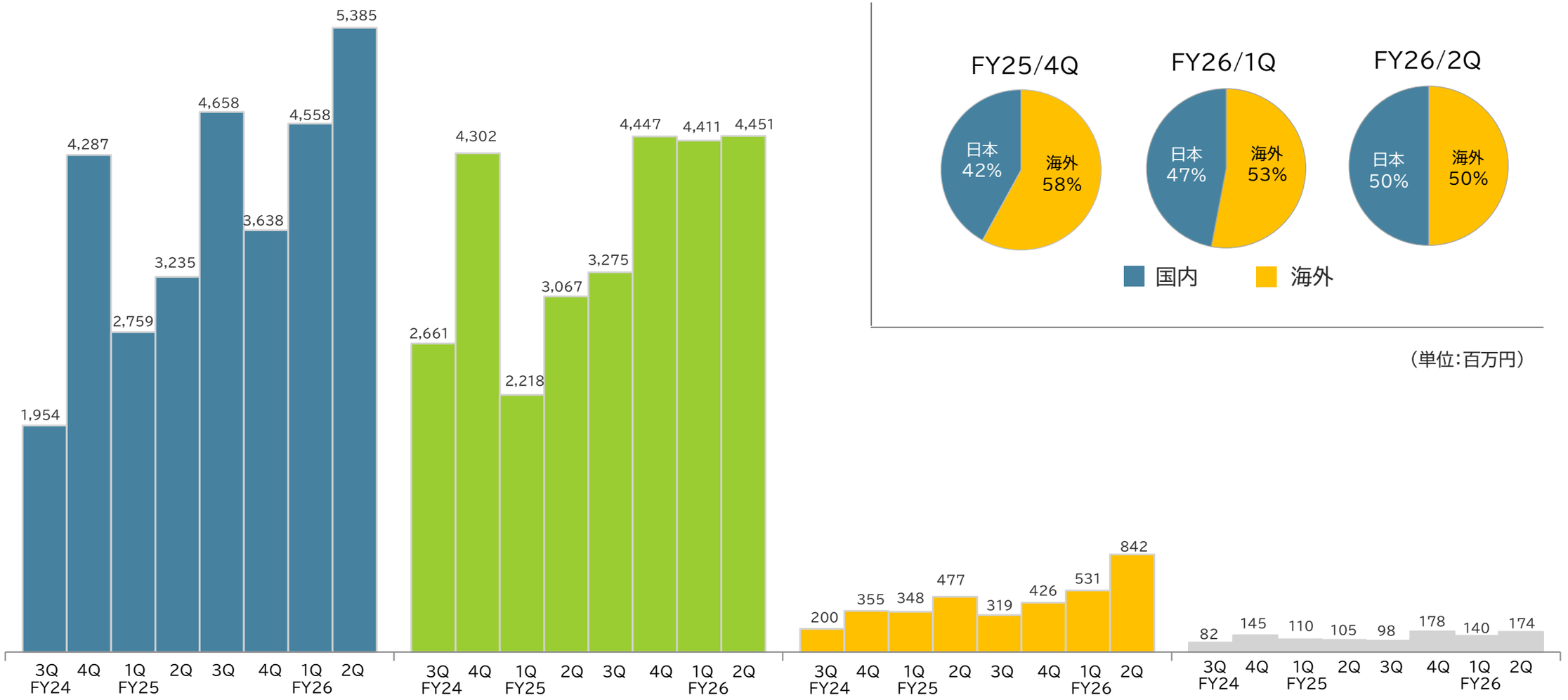
Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

四半期業績推移（地域別）

執行役員
管理部門統括部長
石本　浩久

・主要顧客における先端メモリ向けの需要が高水準で推移し、売上成長を牽引



Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

2027年3月期　通期連結業績予想の修正

代表取締役社長　社長執行役員　坂田　輝久

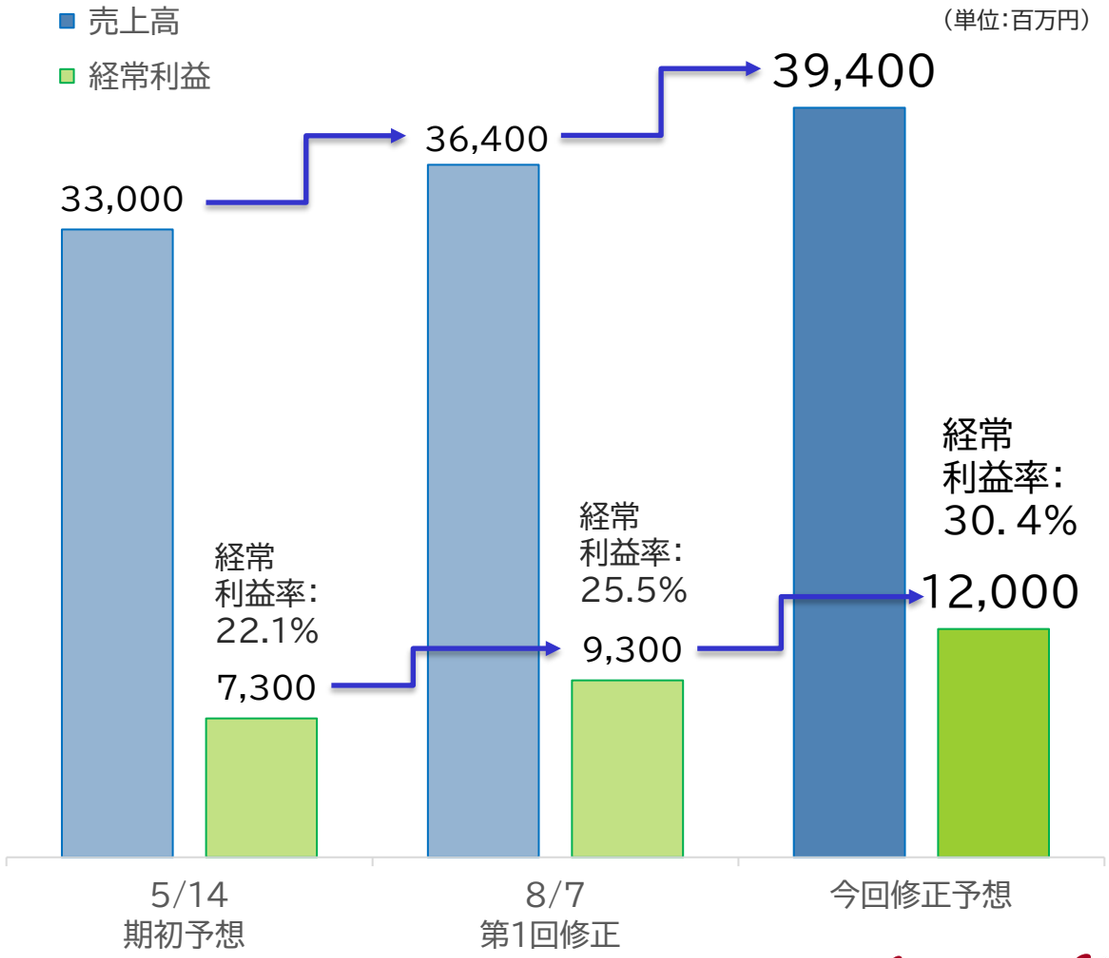
Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

2027年3月期　通期連結業績予想の修正

代表取締役社長
社長執行役員
坂田　輝久

・第1回修正(8/7)対比 売上高は＋30億円(＋8.2%)、経常利益は＋27億円(+29.0%)
・豊富な受注残を背景に、製品ミックス・決算期ずれ・為替を踏まえ再上方修正



売上要因

・先端メモリを中心とする旺盛な市場環境を背景に、豊富な受注残を確保
・受注状況及び製品ミックスに加え、子会社の決算期ずれを織り込んだ計画を策定

利益要因

・主力Mタイプのフル稼働および高付加価値製品の伸長により、高い収益性を維持
・想定為替レートの見直し(140円→150円)による押し上げ効果を反映
・先行費用などを下期に計上

Your Probing Partner

通期連結業績予想の内訳および株主還元

代表取締役社長
社長執行役員
坂田　輝久

・上方修正に伴い、1株当たり年間配当金を120円へ引き上げ（中間60円/期末60円）
・期初80円から100円、さらに今回120円へと利益成長に即した段階的な増配を継続

（単位：百万円）

項目	期初予想 （5/14公表）	第1回修正予想 （8/7公表）	今回修正予想	第1回修正予想比 （増減額／率）
売上高	33,000	36,400	39,400	+3,000　（+8.2%）
営業利益	7,450	9,450	12,100	+2,650（+28.0%）
経常利益	7,300	9,300	12,000	+2,700（+29.0%）
親会社株主に帰属する当期純利益	5,500	6,700	8,200	+1,500（+22.4%）
年間配当金 （1株当たり）	80円	100円	120円	+20円
（中間/期末）	（40円/40円）	（60円/40円）	（60円/60円）	（－/+20円）

※想定為替レート（USD）：下期前提 150円／ドル（期初および第1回修正公表時：140円／ドル、上期実績レート約160円／ドル）

Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

中長期の事業環境見通しと
持続的成長に向けた事業基盤の確立

代表取締役社長　社長執行役員　坂田　輝久

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

中長期の事業環境見通し

代表取締役社長
社長執行役員
坂田　輝久

・生成AIの爆発的な普及に伴い、AIサーバー向けHBM・NANDなどの先端メモリやLogic半導体の需要は、中長期的に拡大が続く見通し
・半導体の高性能化・高集積化に伴い、ウエハー検査の高度化と信頼性確保の重要性が一層高まるとともに、プローブカード市場も中長期的な成長が見込まれる

■ AI需要を起点とした半導体需要の拡大

・AIサーバーを中心とする先端半導体の需要拡大
生成AIの急速な普及とデータセンターなどのインフラ投資拡大を背景に、先端半導体の需要は中長期的に拡大する見通し

・先端メモリ（HBM・NANDなど）の需要伸長
AIの処理性能向上やデータ量の増加に伴い、高速・大容量メモリの需要も継続的に拡大する見込み

■ 半導体生産を支える検査（プローブカード）需要

・ウエハー段階での電気的検査の重要性向上
半導体の高性能化・高集積化に伴い、品質や信頼性を確保するためのウエハー検査の重要性が一層高まる見通し

・半導体増産と検査高度化に伴うプローブカード需要の拡大
先端半導体の生産拡大や検査技術の高度化を背景に、プローブカード需要も中長期的に拡大が期待される

Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

持続的成長を支える事業基盤の確立

代表取締役社長
社長執行役員
坂田　輝久

・既存工場のスペース有効活用や生産ライン増強などにより、供給能力を段階的に引き上げ、旺盛な半導体需要を着実に取り込む
・将来の構造的な需要拡大を見据え、尼崎工場の建設計画を推進し、円滑な立ち上げに向けた体制の整備・準備を進める

■ 既存工場の最大活用と段階的な能力増強

- **既存スペースの有効活用と生産ライン増設による供給能力拡大**
  既存工場のスペースを最大限活用し、生産ラインの増設や設備の拡充により、需要増加に対応した供給能力を段階的に引き上げる
- **重点工程の能力増強による生産性向上**
  Mタイプ製造の3工場の能力増強により生産体制を最適化し、スループット向上を図る

■ 尼崎工場計画の着実な進捗と将来に向けた準備

- **中長期の需要拡大を見据えた新工場建設の推進**
  将来の構造的な需要拡大に対応するため、尼崎工場の建設計画を着実に進める
- **円滑な立ち上げに向けた生産体制の構築準備**
  市場動向や顧客需要を見極めながら、設備導入・人員配置・運用体制の検討と準備を段階的に進める

Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

成長投資の推移（設備投資・研究開発費）

代表取締役社長
社長執行役員
坂田　輝久

・生産現場の高稼働を維持しつつ、能力増強および次世代開発に向けた投資を着実に推進中

（単位：百万円）

		2024年度（2025年3月期）		2025年度（2026年3月期）		2026年度（予想）（2027年3月期）	
設備投資	3か年累計予想額 （ ）内は当初予想に対する増加額	8,500		11,500 （＋3,000）		14,982 （＋6,482）	
	単年度	計画	実績	計画	実績	計画	予想
		4,400	4,015	4,200	3,866	7,000	7,100
研究開発費		1,900	1,538	2,000	1,681	2,200	2,100
減価償却費		1,100	1,196	1,400	1,427	1,800	1,600

Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

質疑応答

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

【参考資料】製品ポートフォリオ・用途別マッピング

CE シリーズ
カンチレバータイプ

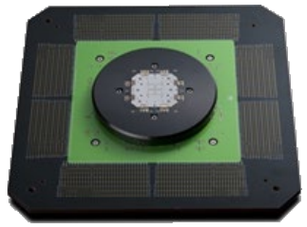
High Density Memory
For DRAM / NAND

Fine-Pitch Logic Devices
For Logic

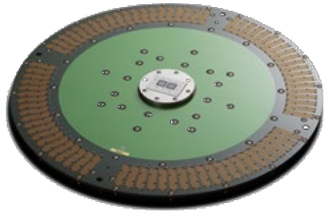
Area-Array Logic Devices
For Logic

Imaging Devices
For CIS

【Vertical タイプ】



VTシリーズ
Logic IC用の垂直針タイプ
ファインピッチパッド用

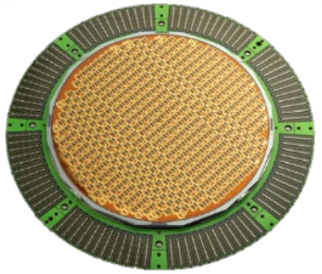


VSシリーズ
エリアアレイとWLCSPの
垂直スプリングタイプバンプテスト用

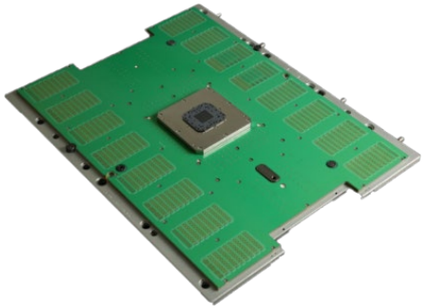


VEシリーズ
CMOS用の垂直型カンチレバータイプ
高並列とMIPIアプリケーション用

【MEMS タイプ】



MCシリーズ
DRAM/NAND用MEMS
マイクロカンチレバータイプ



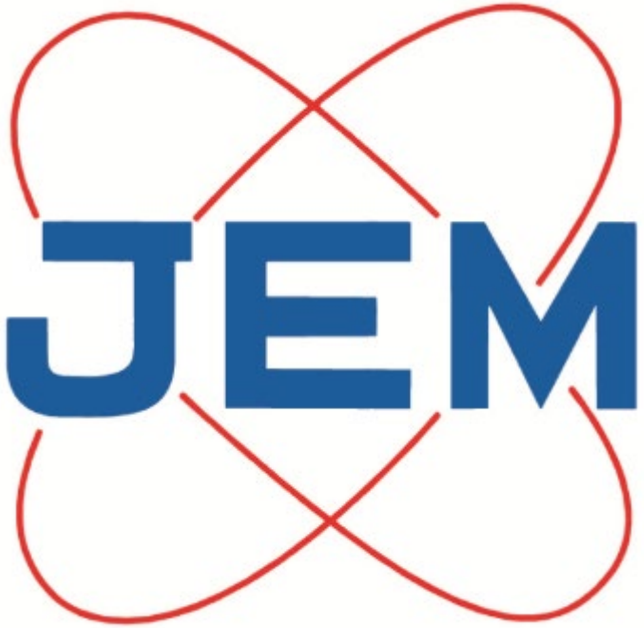
MTシリーズ
Logic IC用の垂直MEMSタイプ
ファインピッチパッドとCuピラー用

開発中

CIS用MEMS

Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION



Your Probing Partner

©2026 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION